



kingston.com/epop

ePoP

ePoP – pamięć typu Embedded Package-on-Package do urządzeń nasobnych

Pamięć ePoP firmy Kingston to wysoce zintegrowany komponent zgodny ze standardem JEDEC, łączący pamięć masową e•MMC (Embedded MultiMedia Card) oraz pamięć DRAM LPDDR (Low-Power Double Data Rate) w rozwiązaniu typu „Package-on-Package” (PoP). Pamięć ePoP jest przeznaczona do montażu bezpośrednio na kompatybilnym układzie SoC (System-on-a-Chip), co pozwala zmniejszyć wielkość płytki drukowanej PCB i zapewnia optymalną wydajność. Pamięć ePoP to idealne rozwiązanie do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, takich jak urządzenia nasobne.

GŁÓWNE ZALETY

- Dzięki możliwości montażu bezpośrednio na głównym układzie SoC, pamięć ePoP jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których występują ograniczenia przestrzenne, takich jak urządzenia nasobne.
- Pamięć DRAM o niskim poborze mocy i zoptymalizowane oprogramowanie sprzętowe zmniejszają zużycie energii, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność wymaganą w zastosowaniach nasobnych zasilanych bateryjnie.
- Upraszcza to projektowanie systemu, skraca czas wprowadzenia na rynek i proces kwalifikacji.
- Dostępne są różne konfiguracje oprogramowania sprzętowego, umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań pod względem wydajności, zużycia energii i żywotności.

SEGMENTY RYNKU



Internet rzeczy



Urządzenia nasobne



Urządzenia z rozszerzoną rzeczywistością (AR)/ wirtualną rzeczywistością (VR)

NUMERY KATALOGOWE I DANE TECHNICZNE PAMIĘCI EPOP

Pamięć ePOP oparta na technologii LPDDR3

Numer katalogowy	Pojemność		Standard		Wymiary	FBGA	Temperatura pracy
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x based ePoP

Numer katalogowy	Pojemność		Standard		Wymiary	FBGA	Temperatura pracy
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

* Tryb pSLC dla zapewnienia większej trwałości